

## ***Presse-Information***

### **Optimale Elektronikauslegung durch Thermosimulation für Geräteentwickler**

(08/23) Mit der Online-Thermosimulation von Phoenix Contact bieten sich neue Möglichkeiten für die geeignete Auslegung von Industrieelektronik bereits in der Entwicklungsphase.

Der Ablauf für das Initiieren der Thermosimulation ist intuitiv. Im ersten Schritt konfiguriert der Kunde sein Gehäuse inklusive benötigter Anschlusstechnik im Online-Gehäusekonfigurator. Anschließend erhält er eine Stückliste, 3D-Daten und die PCB Outline der Konfiguration. Nun folgt der Übergang in die Online-Simulationsoberfläche. Hier werden die thermischen Randbedingungen des Geräts definiert. Dazu gehören die Einbausituation (Einbaulage, mögliche benachbarte Geräte) sowie die Umgebungstemperatur.

Im nächsten Schritt kann der Kunde per Drag-and-Drop bis zu drei unterschiedliche Hot-Spots auf der Leiterplatte platzieren, ihnen eine Geometrie zuweisen und die zu erwartende Verlustleistung eingeben. Anschließend wird die Simulation mit der Eingabe der Kundendaten abgeschickt. Nach spätestens drei Werktagen liegt das Simulationsergebnis für den individuellen Lastfall als 3D-PDF vor. Zusätzlich besteht die Möglichkeit ergänzender Beratung durch das Team von Phoenix Contact.

**5547**      Bitte bei Kennziffer-Veröffentlichungen für die Leserdienst  
                 Zuordnung angeben

## ***Press Release***

### **Optimal electronics design through thermal simulation for device developers**

(08/23) Online thermal simulation from Phoenix Contact offers new possibilities for the suitable design of industrial electronics as early as the development phase.

The procedure for initiating the thermal simulation is intuitive. In the first step, the customer configures their housing (including the required connection technology) in the online housing configurator. They then receive a parts list, 3D data, and the PCB outline of the configuration. The customer now switches to the online simulation interface. The thermal boundary conditions of the device are defined here. This includes the installation situation (mounting position, possible neighboring devices) as well as the ambient temperature.

In the next step, the customer can use drag and drop to place up to three different hot spots on the PCB, assign them a geometry, and enter the expected power dissipation. The simulation is then sent with the customer data input. Within three working days, the simulation result for the individual load case is available as a 3D PDF. The Phoenix Contact team is also able to provide additional advice.

**5547**